

Techado IC



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

CONDICIONES DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío para disminuir el riesgo de condensación.

Sustratos cementicios

El hormigón nuevo debe dejarse secar durante al menos 28 días y deberá tener una resistencia al pull-off ≥ 1.5 N/mm².

Inspeccionar el hormigón, incluso los elementos pasantes y realizar una prueba con martillo en todas las áreas.

El hormigón deberá tener un acabado preferentemente alisado con fratás o llana metálica.

Se pasará la amoladora para retirar restos de material e irregularidades.

El acabado de la superficie debe ser uniforme y debe estar libre de defectos tales como chorreaduras, manchas o nidos de abeja.

Se debe remover por completo todo material y concreto flojo y todos los defectos superficiales, tales como nidos de abeja.

Consultar la Sección Límites de Aplicación que figura a continuación.

Las reparaciones en el sustrato, relleno de juntas, burbujas / manchas y la nivelación de la superficie deben realizarse utilizando productos.

La desgasificación es un fenómeno que ocurre naturalmente en el hormigón y puede producir burbujas en los recubrimientos aplicados posteriormente.

Se debe evaluar cuidadosamente el hormigón para calcular el contenido de humedad, la entrada de aire y el acabado de la superficie antes de realizar cualquier tarea de recubrimiento.

Para reducir la desgasificación se puede instalar la membrana ya sea cuando la temperatura del hormigón está descendiendo o bien cuando está estable.

Ladrillos y piedras

Las juntas con mezcla deben ser firmes y preferentemente desbastadas.

Reponer la mezcla faltante y lavar utilizando hidrolavadora.

Esperar hasta que las baldosas cerámicas se sequen.

Asegurarse de que todas las baldosas se encuentren sujetas firmemente y reemplazar aquellas secciones que a simple vista estén rotas o falten.

Las baldosas deben estar bien adheridas al sustrato, de lo contrario deberán ser removidas.

Compruebe que las baldosas estén bien adheridas a la superficie ya que se podrá requerir su raspado para lograr una buena adherencia.

Desengrasar utilizando detergente o un agente desengrasante de buena calidad.

Lavar con hidrolavadora y esperar hasta que seque.

APLICACIÓN

En la aplicación se seguirán los siguientes pasos:

1. Sobre la superficie limpia y seca de la carpeta se aplicará a cepillo o pinceleta una mano de imprimación con sellador 7667 con un consumo mínimo de 1 kg/ m².
2. Una vez seca la emulsión de sellador 7667 , mediante una pinceleta nº 50 se aplicará una primer mano de Techado IC con un consumo de 0.500 kg / m².
Durante esta aplicación es recomendable colocar una malla de 100% de poliéster de 60 gr/m² de manera de producir una base elástica, impermeable de altísima resistencia.
3. Cuando se compruebe el secado anterior (aproximadamente 12 horas) se aplicará con pinceleta la segunda capa de Techado IC con un consumo de 0.500 kg / m².
4. Una vez seca las ultimas aplicaciones descriptas, (aproximadamente 24 horas), se aplicará la tercera capa de Techado IC en iguales condiciones concentrando sobre la superficie 0.500 kg/m²
5. En no menos de 24 horas, después de la colocación de la tercer mano una vez polimerizado, se aplicará 0.500 kg / m² en una cuarta aplicación.

PRECAUCION Cuando el producto este asentado o separado al abrirlo, se deberá revolver el por completo para obtener un color uniforme. Mezclar lentamente para evitar la entrada de aire.

SEGURIDAD E HIGIENE

Techado IC no es tóxico.

Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.

Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.

Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.

Transporte: sustancia no peligrosa

Toxicidad: no es toxico ni inflamable.

Producto no peligroso para el uso normal previsto

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Techado IC

